

# **Prosave**<sub>TM</sub>



## **Heat Resistant** (150°C) For High Temperature

耐熱 150℃ 熱のかかる工程に

Heat resistant adhesive layer, for optimum protection And reinforcement in processes involving heat. Low adhesive residue after heating for easy peeling. Stable peel strength even during heating. Choose THS for short-term,

high temperature usage and SHR for longer-term uses. SHR prevents oligomer precipitation and maintains its transparency even after heating.

Anti-static substrate surface.

#### Main Use

- Protection for hard-coat film
- Backing film when printing conductive paste
- Protection for screen printing
- For copper foil carrier
- Protection in other processes using heat

粘着層が耐熱のため、熱処理工程での 保護材・補強材に最適です。 加熱後の糊残りも少なく、再剥離が容易です。 加熱時も安定した粘着力が持続します。 高温下短時間の使用には THS を、 長時間の使用には SHR をお選びください。 SHR はオリゴマー析出を防止し、 加熱後も透明性を維持します。 基材表面は帯電防止処理加工。

#### 主な用途

Anti Static /

- ハードコートフィルムの保護として
- 導電ペースト印刷時の裏打ちフィルムとして
- シルク印刷時の保護として
- 銅箔キャリア用として
- その他熱のかかる工程の保護として

#### Structure 構造

THS	
Anti Statics	帯電防止層
Base Material	基材
Heat Resistant PSA	耐熱粘着層
Release Liner	セパレーター

	SHR	Prevent Precipitati	on of Oligomer
	•—/	帯電防止・オリゴ	マー析出防止層
+	Base I	Material	基材
i	Heat I	Resistant PSA	耐熱粘着層
	Relea	se Liner	セパレーター

#### **Thickness 厚み** [μm]

THS

	THS	SF	łK
Base Film 基材	25	25	50
Adhesive Layer 粘着層	2.5	10	10
Release Liner セパレーター	25	25	25

Adhesive Property 粘着特性 Initial Strength 初期粘着力[N/25mm]			Antistatic Performance 帯電防止性 Surface Resistivity 表面抵抗率(AS性) [Ω/□]	
0.072	0.06	0.085	0.035	2.8×10 <sup>9</sup>
0.1	0.08		0.07	1.6×1010

#### **Heat Resistance**

#### 耐熱性 [150°C]

Adhesive transfer and no adhesion failure from adherend weren't noticed, even when heating Up to 150℃. (THS/30min SHR/360min)

150℃で過熱後も 糊残りや被着体からの浮きが ほとんどありません (THSで30分、

150°C⋅30min. Peel s	trength after heating
---------------------	-----------------------

150℃・30分加熱後の粘着力

		Peel Strength 粘着力[N/25mm]	<b>Adhesive Transfer</b> 糊残り	Adhesion Failure 被着体からの浮き
THS	PET	0.1	none	none
	Glass	0.11	none	none
	SUS	0.09	none	none

#### 150°C·6hr. Peel strength after heating

150℃.6時間加熱後の粘着力

		150 C 6時間加热後の相看力			
		Peel Strength 粘着力[N/25mm]	Adhesive Transfer 糊残り	Adhesion Failure 被着体からの浮き	
SHR	PET	0.33	none	none	
	Glass	0.3	none	none	
	SUS	2.58	none	none	

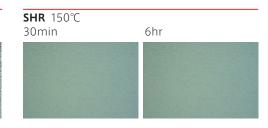
#### Adhesive Transfer after heating at 150 C for 30min 150℃で加熱後の糊残り

Adherend: SUS 被着体:SUS

SHRは6時間後まで)







Reliability Change in peel strength after applying to each adherend

信頼性 各被着体と貼り合わせ後の粘着力の変化

Little increase in Peel Strength, in high temperature and humid condition.

高温や多湿の環境でも 粘着力の上昇が ほとんどありません

	High Temperature & Humidity 高温多湿		High Temperature 高温			
[N/25m	m]	THS:65°C95%RH∕S	THS:65°C95%RH∕SHR:60°C90%RH		80℃	
0hr 50		500hr	0hr	500hr		
THS	PET	0.072	0.076	0.072	0.101	
	Glass	0.06	0.045	0.06	0.079	
	SUS	0.035	0.086	0.035	2.254	
SHR	PET	0.1	0.15	0.1	0.18	
	Glass	0.08	0.08	0.08	0.09	
	SUS	0.07	0.28	0.07	0.26	

Caution: Adhesion transfer may occur with SUS after high temperature storage.

注意:SUS等金属に貼りあわせて高温下で長時間経過した場合糊残りすることがあります。

The peel strength test values provided are measured by peeling conducted at 300mm/min and 180° from the Prosave side. (Based on JIS Z-0237) 粘着力試験は、プロセーブ側から300mm/min、180°で剥離した測定値です。(JIS Z-0237に準拠)

The table shows typical test results and does not guarantee material value.

いずれの値も任意のサンプルの測定値であり保証値ではありません。

All product specifications are subject to change without notice. 記載内容は断わりなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### **KIMOTO**

#### Kimoto Co.,Ltd

office030@kimoto.co.jp http://www.kimoto.co.jp

#### 株式会社 きもと

office030@kimoto.co.jp http://www.kimoto.co.jp

	88. ·	$\sim$	ᄔᄮ
- 451	77 L.	<u> </u>	せ先